

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/naprawa-sciezek-padow-sciezki-pady-regeneracja-mechanic-gs2-lakier-uv-gy14-p-6558.html>

NAPRAWA ŚCIEŻEK PADÓW ŚCIEŻKI PADY REGENERACJA MECHANIC GS2 LAKIER UV GY14

Cena brutto	42,28 zł
Cena netto	34,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XNWA0001546
Kod EAN	6949639144898

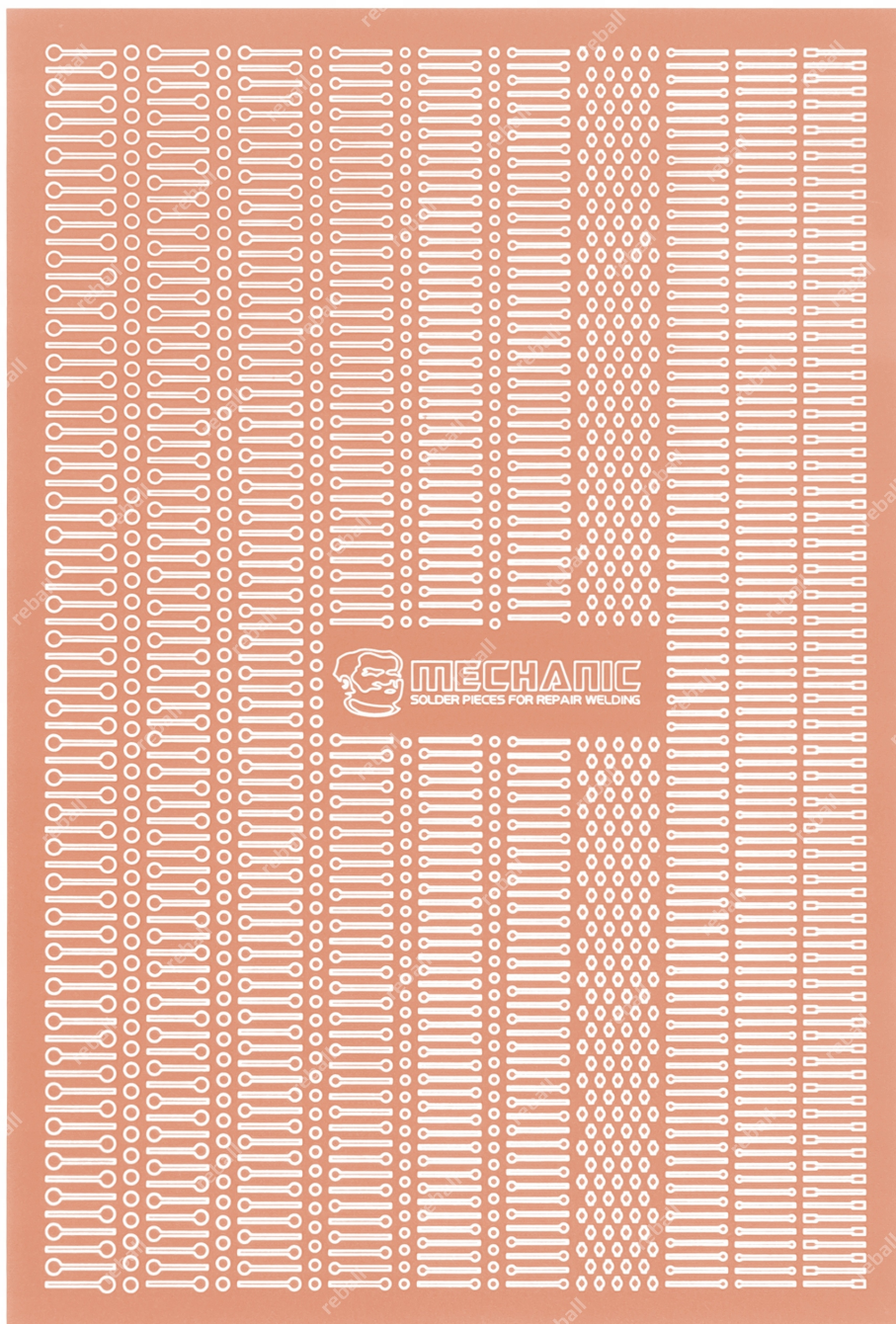
Opis produktu

NWA0001546

ZESTAW PADÓW I ELEMENTÓW ŚCIEŻEK DO NAPRAWY LAMINATÓW PCB

W ZESTAWIE ZIELONY LAKIER UV GY14

* Firma Reball Technology Sp. z o.o. jest bezpośrednim oficjalnym dystrybutorem marki MECHANIC.



☐ Zestaw naprawczy - Mechanic GS2 ☐

Zestaw padów i ścieżek z padami w różnych rozmiarach do **regeneracji laminatów PCB** w sytuacji kiedy doszło ich uszkodzenia.

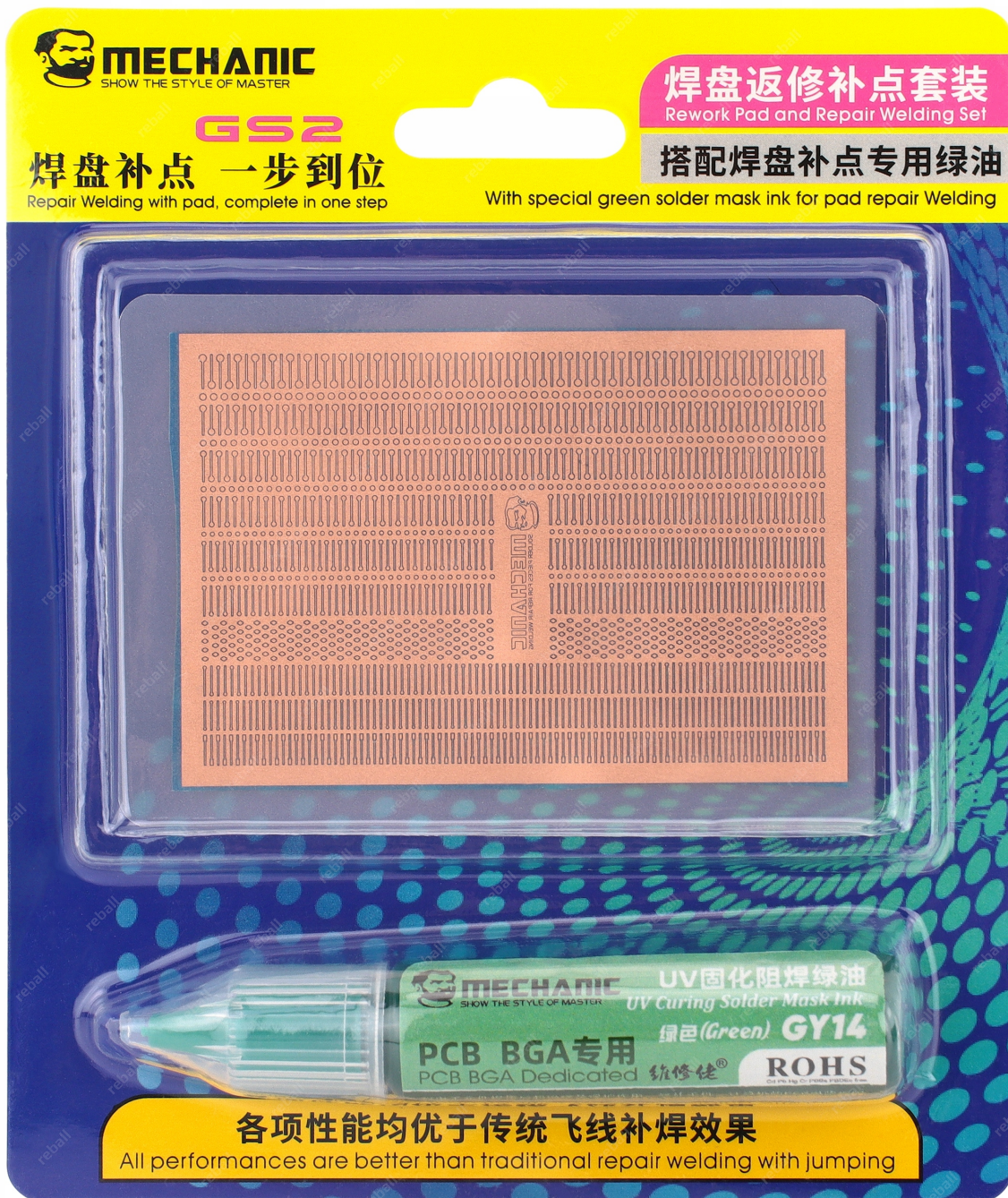
Pady można przylutować w miejscach uszkodzenia (kiedy wyprowadzenia z warstw laminatu są dostępne) jak i przykleić na **lakier UV** dołączony w zestawie.

Grubość **miedzianych ścieżek** to tylko 30um.



REBALL
TECHNOLOGY

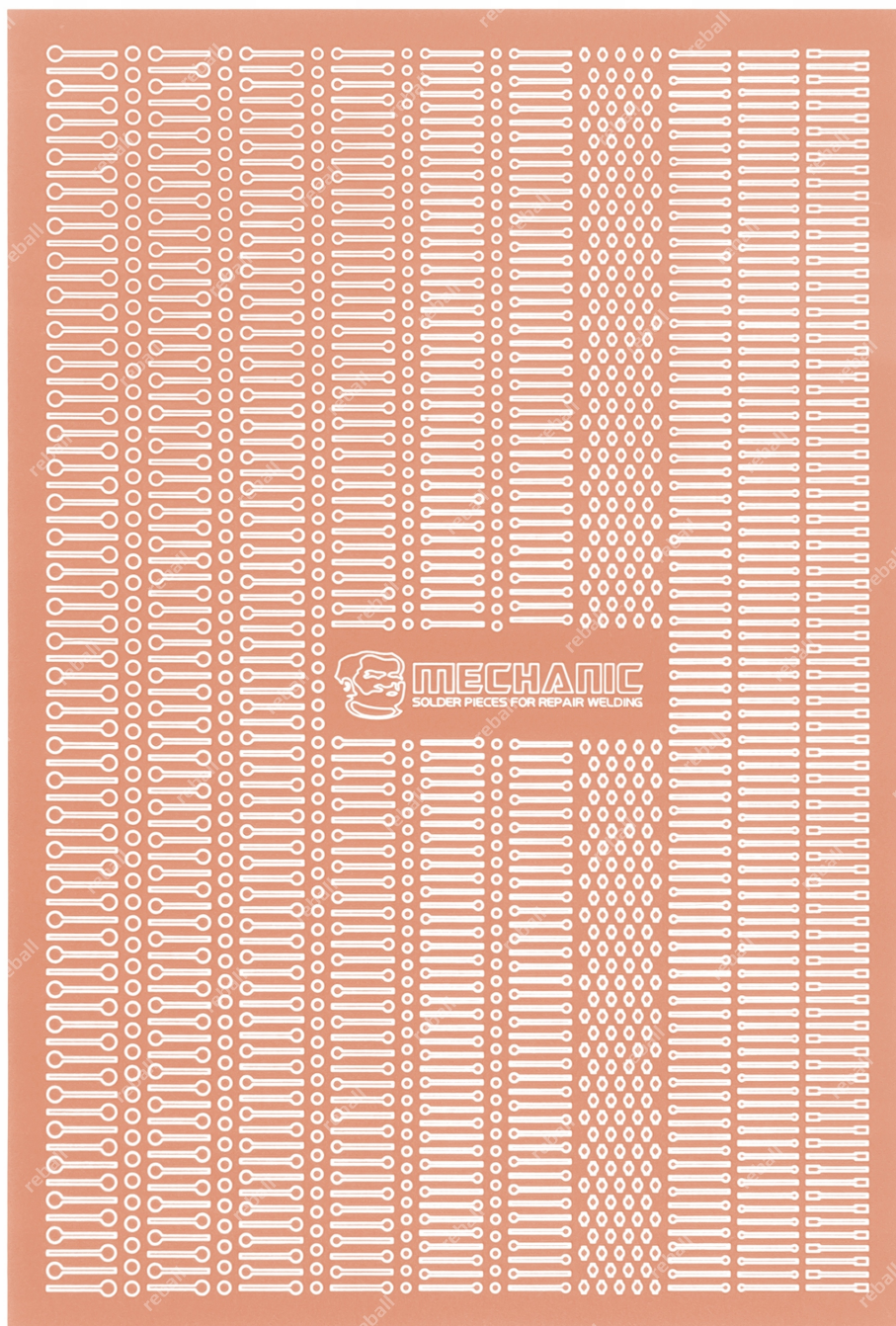
Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



☐ Zestaw szczególnie polecany do naprawy

- laminatów w telefonach komórkowych, tabletach bądź laptopach.
- regeneracji padów układów BGA.

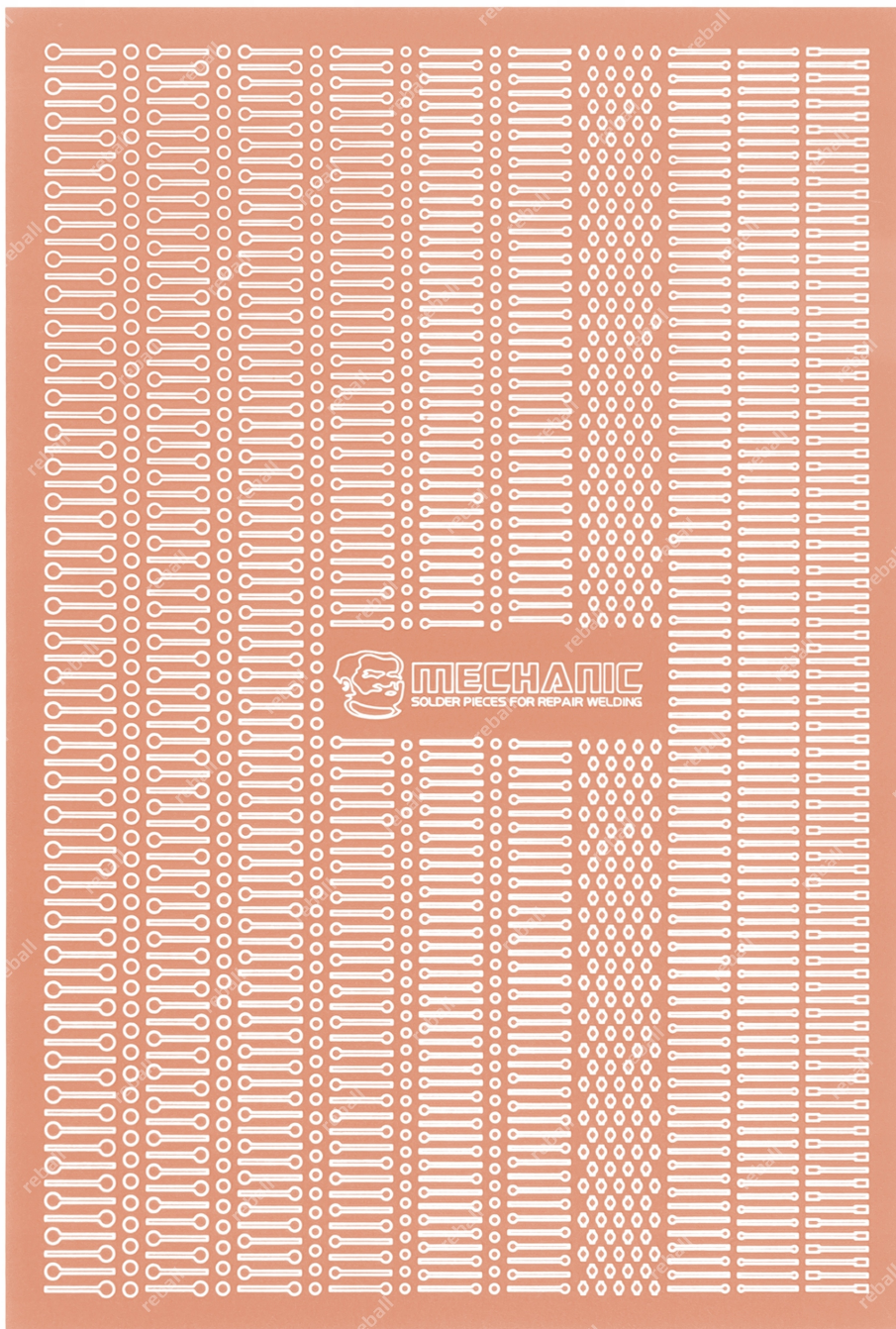
Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie używania zestawu **Mechanic GS2** znajdziesz na **YouTube**.



☐ Zawartość zestawu

- ☐ **Miedziana folia z padami** - 1szt.
- ☐ **Zielony lakier UV GY14 10cc/10ml** - 1szt.

W naszej ofercie znajdziesz również szeroki wybór mikroskopów marki Mechanic. Szczególnie zalecane w regeneracji ścieżek.







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



MECHANIC
SHOW THE STYLE OF MASTER

GS2

焊盘补点 一步到位

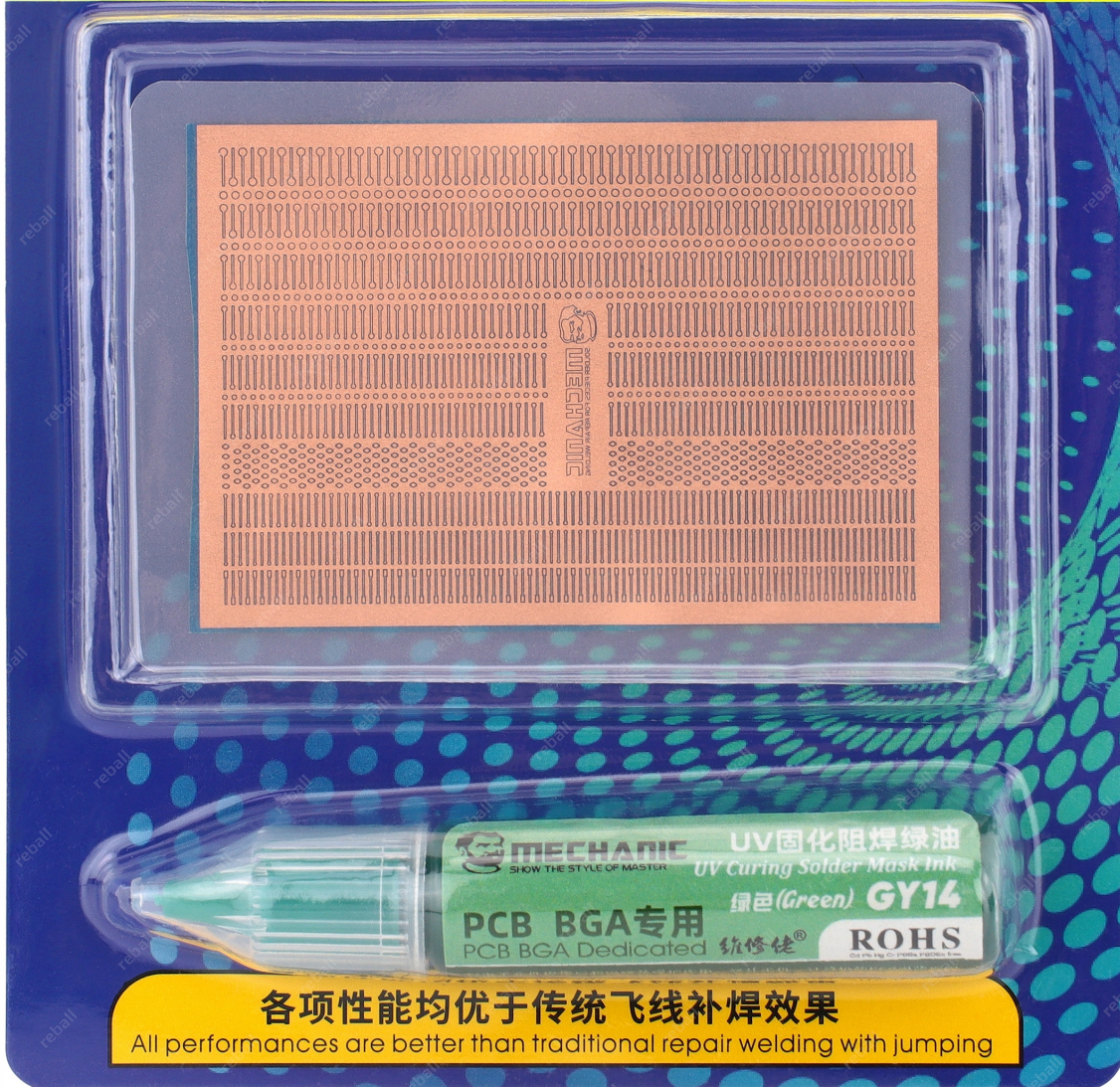
Repair Welding with pad, complete in one step

焊盘返修补点套装

Rework Pad and Repair Welding Set

搭配焊盘补点专用绿油

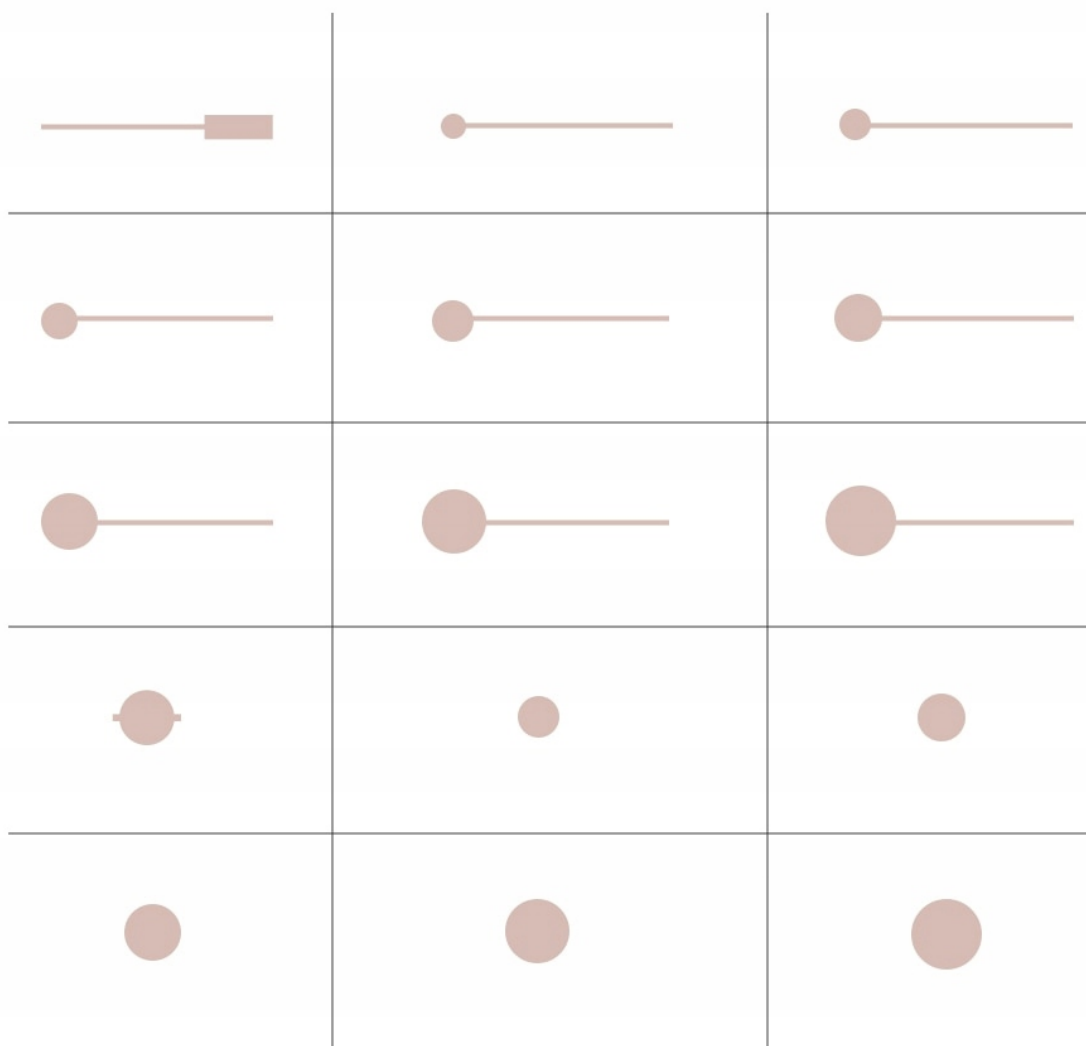
With special green solder mask ink for pad repair Welding



各项性能均优于传统飞线补焊效果

All performances are better than traditional repair welding with jumping

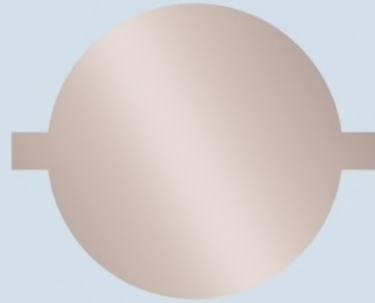
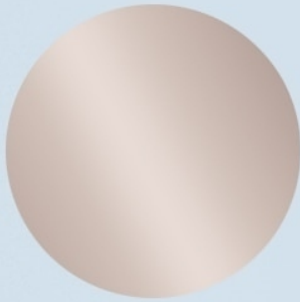
Suitable for pads with different size



Used in the repair field, like the IC pad of the mobile phone motherboard or the middle layer of the double-layer motherboard/CPU/WIFI/hard disk/big audio/touch IC/ and other pads. Repair the falling part of the pad due to drop, shock or extrusion, restore to the original pad and make it more stable!



Add a fixed pin on the original pad to prevent the solder piece from falling off



1st generation
without fixed pin

2nd generation
with fixed pin

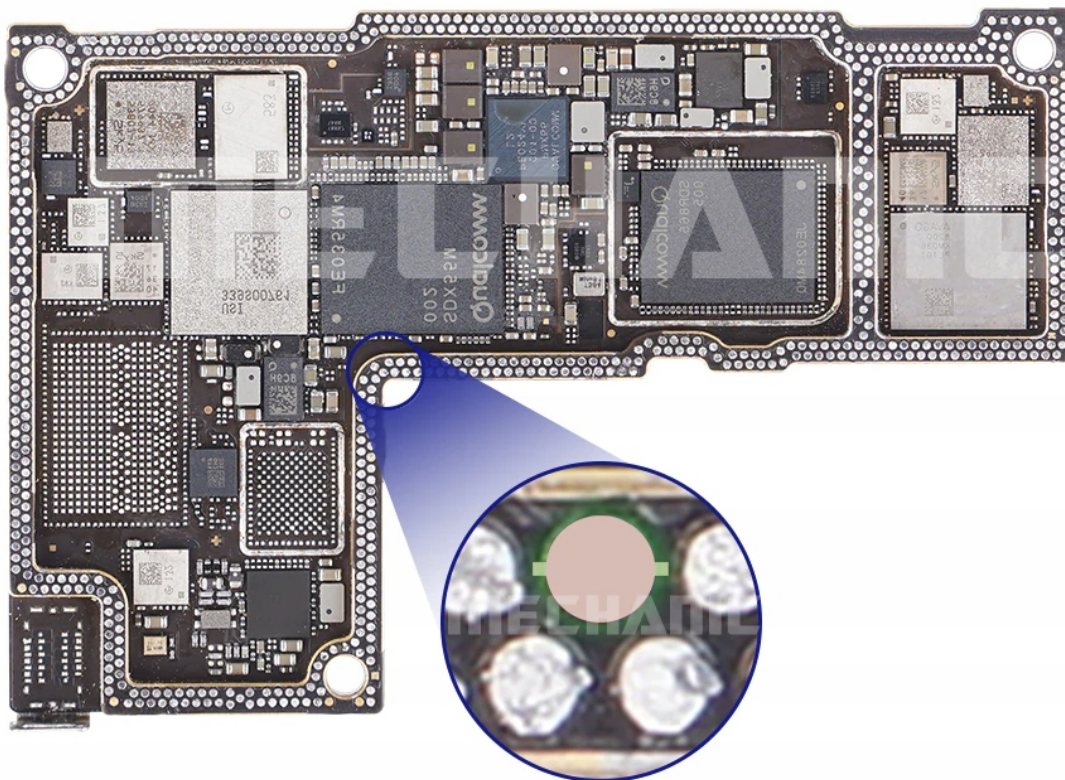


1st generation
thickness: 60µm

2nd generation
thickness: 30µm

Various shape and specifications, suitable for different pad with dropped solder joint

2nd generation



- The pads are reinforced with fixed pins and will never fall off.
- It adopts industrial-grade printed circuit board copper foil with a thickness of 30 μ m.
- Good flatness, which can prevent pseudo soldering effectively caused by unevenness.
- The BGA bonding surface has high saturation, stable electrical performance, good welding strength, and it is not easy to drop off and unsoldering.
- The connection joint with the circuit is firm, and can fixed the green oil (UV curing solder mask ink) well.
- It saves time and effort and no need to circle during jumping wire so the repair efficiency is relatively high.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.